# n 型透明导电薄膜 $CdIn_2O_4$ 电学性质的研究 和大面积制备的最佳条件\*

~ 金海生 陈 冲 何毓阳 王 君 冯博学

(兰州大学磁学与磁性材料教育部重点实验室,兰州 730000) (2004年3月30日收到2004年11月17日收到修改稿)

在 Ar + O<sub>2</sub> 气氛中,采用射频反应溅射 Cd-In 靶制备 CdIn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 薄膜. 制得的薄膜经 x 射线衍射( XRD )检测为 CdIn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 和 CdO 相组成的多晶.从理论上分析了热处理前后氧空位、掺杂点缺陷和富氧电子陷阱在影响膜的载流子 浓度和电子散射中所起的重要作用.同时,对样品进行 Hall 效应、Seebeck 效应测试并得出不同载流子浓度下的迁 移率、有效质量、弛豫时间以及它们之间的相互关系,特别强调了弛豫时间的重要性.为了提高导电膜的透射率,还 分析了 Burstein-Moss 漂移和带隙收缩对光带隙的影响,并在薄膜制备时选择了合适的衬底温度  $T_{\rm s} \approx 280 \,^{\circ}$ .实验表 明 在氧分压为 8% 左右时制备的薄膜质量较好,热处理后的指标大约为迁移率  $\mu_{\rm H} = 31 \times 10^{-4} \,^{\circ}$ /V·s,电阻率  $\rho = 1.89 \times 10^{-5} \,^{\circ}$ O·m.

关键词:射频反应溅射,CdIn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>透明导电薄膜,导电机制,带隙收缩 PACC:6855,8155C,7360

## 1.引 言

透明导电薄膜(TCOs)的研究及应用已有 40 多 年的历史,目前仍有许多国家还在继续这方面的研 究,这主要是由于大面积、经济适用的 TCOs 的需求 在持续增加,如在平板显示、光电池、热反射膜、航天 器涂层、调光玻璃等方面<sup>[1-3]</sup>.现在商业 TCOs 主要 是采用 Sn 掺杂的 In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(TTO).

三元氧化物 CdIn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>( CIO )薄膜是宽带隙高简并 的 n 型半导体薄膜 ,在一定衬底温度及低氧浓度条 件下制备的具有缺陷态 CIO 膜经热处理后具有优良 透明导电性和红外区高反射特性 ,使它在透明电极 和热镜等方面的应用具有诱人的前景<sup>[4,5]</sup>.

本文主要是对射频反应溅射法制得的 CIO 导电 膜的导电性进行研究,并对影响其导电性能的一些 因素进行分析和测试,从而得到最佳的制备条件.

## 2.实验

2.1. 薄膜的制备

CIO 薄膜是在 Ar + O2 混合气氛中经射频反应

溅射 Cd-In 合金靶沉积获得的. 实验采用纯度为 99.99%的金属 Cd 和 In 做成原子比为 1:2 的合金 靶,直径为 100 mm. 靶到玻璃衬底的距离为 35 mm. 衬底用碘钨灯加热并用 Pt-Rh 热电偶测量其温度. 溅射功率为 300 W. 溅射前将溅射腔抽真空到 1.00 ×10<sup>-3</sup> Pa, Ar 与  $O_2$  分别通过两个管道经质量流量 控制仪送入腔中并混合,溅射时总压强控制为 1.33 Pa.基片为 corning7059 玻璃,衬底温度控制在 280 ℃,沉积时间为 30 min. 沉积后的薄膜热处理是在 300 ℃稳定的 Ar 气环境中进行 60 min.

#### 2.2. 薄膜的测试

利用 van der Pauw<sup>[6]</sup>法在 1.025 T 的磁场下测 量样品的电阻率  $\rho$  和 Hall 系数  $R_{\rm H}$ ,迁移率

$$\mu_{\rm H} = R_{\rm H}/\rho$$

载流子浓度

 $n = - f_{\rm h}/eR_{\rm H}.$ 

这里  $f_h$  为系数 ,它依赖于散射类型和简并程度 ,高 简并时  $f_h = 1$ .

利用温差电势率(Seebeck 系数)确定有效质量 及弛豫时间.图1为经过我们改进的Seebeck系数测

<sup>†</sup>通讯联系人. E-mail:fengbx@lzu.edu.cn

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号 159876018)和国家高技术研究发展计划(批准号 2001AA312190)资助的课题.

量装置示意图<sup>71</sup> 测量温度范围为 300—350 K. 由图 1 可见 ,铜与康铜热电偶连接点的一端被绝缘地置 入温度为 273 K 的冰-水混合液中作为参考点 ,另一 端被紧密地连接在样品的两端以测两端的温度差 △*T*.为避免康铜费米能级对铜与 CIO 膜的接触电势 差产生影响而引起测量误差 ,在靠近铜-康铜与样品 接触点处再引一条铜线以测铜与 CIO 薄膜的温差电 动势 ,测量结果如图2所示 .结果表明 :实验拟合直



图 1 Seebeck 系数测量装置示意图



图 2 不同载流子浓度样品的 Seebeck 系数与温度变化的关系

线的斜率为正值,说明 CIO 膜为简并半导体.对于简 并半导体 Seebeck 系数与温度 T 的关系可表示为<sup>[8]</sup>

$$a_{e} = \frac{\pi^{2} k_{B}^{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}p\right) T}{|e| E_{F}} , \qquad (1)$$

式中 , $E_{\rm F}$  是费米能 ; $k_{\rm B}$  是 Boltzman 常数 ;p 是与弛豫 时间  $\tau$  有关的散射参数 ,其关系式为  $\tau = \tau_0 e^p$ .对于 CIO 膜 p = 3/2 ,主要为离子化杂质散射<sup>71</sup>.将简并半 导体费米能表达式代入(1)式可得

$$a_{e} = \frac{2\pi^{3/2} k_{\rm B}^{2} m_{e}^{*} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}p\right)}{|e| \hbar^{2} (3n)^{2/3}} T = AT , \quad (2)$$

式中, $\hbar$ 是约化 Planck 常数,n是载流子浓度, $m_{e}^{*}$ 是载流子有效质量.利用图2拟合直线斜率A,就可 根据(2)武求出 $m_{e}^{*}$ .

## 3. 实验结果与讨论

#### 3.1.CIO 薄膜的导电机制

影响 CIO 薄膜载流子产生的因素大致有四个 方面.

3.1.1. 阴离子空位模型

低氧分压条件下制备出的具有非化学计量比化 合物 CdIn<sub>2</sub>O<sub>4-x</sub>.氧空位 V<sub>0</sub>成为带正电的施主中 心,在它的周围能束缚两个准自由电子而维持局部 的电中性,在外部电场的作用下成为自由电子而作 定向移动.用 Kröger-Vink 符号表达的缺陷反应方程 式为

$$O_0^x \Leftrightarrow V_0^{"} + \frac{1}{2}O_2 + 2e ,$$

$$n = \sqrt{V_0^{"}} 1$$
(3)

这里,方括号被用来显示被讨论的点缺陷类型(如 Cd代表镉,V代表空位等)的浓度,n代表载流子的 浓度,缺陷类型的上标表示电荷的性质和数量(如 " x "代表电中性",·"代表正电荷","代表负电荷), 缺陷类型的下标表示点缺陷所处的位置(如 i 表示 间隙位置,0表示氧的位置,In表示铟的位置等). 3.1.2. 阳离子添隙模型

通过调整靶中金属的比例含量,过剩的金属离 子 Cd<sup>2+</sup>,In<sup>3+</sup>进入膜内间隙位置并带正电成为施主 中心,等价的电子束缚在其周围保持电中性.这与一 些文献报道把样品放在 Ar/CdS 的环境中热处理提 高载流子浓度具有相同的理由<sup>[9]</sup>.缺陷反应方程式 为

$$Cd_{Cd}^{x} + In_{In}^{x} \Leftrightarrow Cd_{i}^{"} + In_{i}^{""} + 5e,$$

$$n = 2[Cd_{i}^{"}] + 3[In_{i}^{""}].$$
(4)

#### 3.1.3. 阳离子置换模型

由于 Cd<sup>2+</sup>, In<sup>3+</sup> 半径相差 0.015 nm, 且八面体比 四面体间隙大, 两离子的置换是可能的<sup>[10]</sup>. 剔除掉 [Cd'<sub>in</sub>]与[In<sup>-</sup><sub>cd</sub>]之间的补偿, 如果[In<sup>-</sup><sub>cd</sub>]>[Cd'<sub>in</sub>]则 会促使载流子浓度增加, 而[In<sup>-</sup><sub>cd</sub>]<[Cd'<sub>in</sub>]时, 电中 性由  $V_0^{-}$  来平衡则会减小载流子浓度.由于 Cd 是易 挥发性物质(1.3 Pa 时,蒸发温度为 537 °C),在溅射 和热处理时,Cd 蒸发后留下的 Cd 空位  $V_{ca}^{-}$ 很容易被  $In^{3+}$ 填充造成[ $In_{Cd}^{-}$ ]>[Cd'<sub>In</sub>],In/Cd 比例的加大会 形成  $Cd_{1+x-y}^{2+}In_{2-x+y}^{3+}O_{4-z}^{4-}(x \ll y)$ ,总体是加大了载流 子浓度.缺陷反应方程式为

 $x \operatorname{Cd}_{\operatorname{Cd}}^{x} + y \operatorname{In}_{\operatorname{In}}^{x} + z \operatorname{O}_{0}^{x}$   $\Leftrightarrow x \operatorname{Cd}_{\operatorname{In}}^{\prime} + y \operatorname{In}_{\operatorname{Cd}}^{\prime} + z \operatorname{V}_{0}^{\circ} + \frac{1}{2} z \operatorname{O}_{2} + (2z + y - x) e ,$  $n = \{ \operatorname{In}_{\operatorname{Cd}}^{\circ} \} + 2 [\operatorname{V}_{0}^{\circ}] - [\operatorname{Cd}_{\operatorname{In}}^{\prime}] \} > 0.$ (5)

3.1.4. 电子陷阱模型

在膜的晶界和颗粒内部气孔中的富余氧充当电 子陷阱,它不但俘获载流子成为带负电的中心成为 深层施主能级,而且在晶界附近形成的肖特基势垒 散射载流子,进而影响载流子的迁移率<sup>4]</sup>.

# **3.2.** Burstein-Moss(B-M)漂移和带隙收缩对 CIO 光带隙的影响

高浓度的点缺陷不但引起高的载流子浓度,而 且对半导体能带结构有重要影响.这些影响主要体 现在带尾的形成、B-M 漂移和带隙收缩.

当载流子浓度 n 超过 Mott 转变临界浓度 n<sub>Mot</sub> 时 施主波函数开始重叠并出现多体效应<sup>111</sup>.这时, 电子与电子之间存在库仑相互作用和交换能,以及 电子与施主杂质离子(这时载流子的屏蔽效应不能 忽略)的相互作用.这就使原位于禁带中分立的施主 能级扩展成杂质带并与导带交叠使费米能级深入导 带形成简并电子气,同时形成 Urbach 带尾使导带下 移.同理,价带顶的少数空穴也与电子气和屏蔽过的 施主杂质离子发生作用形成价带带尾使价带上移. 从图 3 可以看到 CIO 的光带隙由两部分决定:一是 电子气简并引起 B-M 漂移使带隙加宽,二是多体效 应引起 Urbach 带尾使带隙收缩.

由于偏高衬底温度有利于形成具有理想化学配 比的薄膜材料使缺陷态的数量减少,较低的载流子 浓度使 B-M 漂移的效应减弱.而偏低的衬底温度虽 然容易制备出具有非化学计量比的薄膜,使内部缺 陷态数量相对较多并产生较高的载流子浓度.但是, 多体效应引发的带隙收缩对 B-M 漂移有抵消作用. 所以,选择一个适中的衬底温度可以产生最大的光 带隙并达到最佳的光透性.在以前的论文<sup>[12]</sup>里,我 们已通过实验详细地论述了这部分内容并确定了最



图 3 n型简并半导体 CIO 能带结构示意图 (a) 纯氧化物,基本带隙为  $E_g^0$ (b) 有大量的施主缺陷态( $n > n_{Mot}$ ),由于多体效应 使价带上移而导带下移,带隙收缩  $\Delta E_g^N$ 减消了 B-M 增宽  $\Delta E_g^{BM}$ .图中的  $k_F$  是费米波数

佳的衬底温度为  $T_s \approx 280 \, \%$  左右.

#### 3.3. CIO 的电学特性

CIO 属尖晶石结构,具有空间群  $Fd\overline{3}m$ ,即在面 心立方密堆的氧负离子间隙当中 Cd 占 1/8 四面体 间隙, In 占 1/2 八面体间隙.另外还存在中间相  $(Cd_{1-x}In_{x})^{et}(Cd_{x}In_{2-x})^{vet}O_{4}$ .

采用 Cd-In 靶经射频反应溅射制备的 CIO 膜为 n 型高简并半导体,氧分压、衬底温度和热处理条件 等均对膜的光学、电学性能有影响.

图 4 是 CIO 薄膜的掠射角 XRD 谱图 . 从图 4 曲 线 *b* 和 曲 线 *c* 可 看 出 , CIO 膜 由 CdIn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 相 与 CdO



图 4 CIO 薄膜的掠射角 XRD 谱图 薄膜是在氧浓度为 6%,总 压为 1.33 Pa 下沉积的.曲线 *a* 的衬底不加热,测量的掠射角为 0.8° 曲线 *b* 和曲线 *c* 的衬底温度为  $T_s = 280$  ℃,掠射角分别为 1.0°和 0.6°

相组成 ,CdIn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 相在表面的结晶化程度不高 ,但在 膜的内部和底层  $2\theta = 38.5^{\circ}$ 处出现 CdO 衍射强峰并 沿(200)方向择优生长 ,由于 CdO 含量很少而不予 考虑.各峰位置与标准卡片对照  $2\theta$  稍右偏表明晶格 发生畸变.热处理后衍射峰高度增大.曲线 a 为衬 底不加热制得的非晶膜 ,由于带隙中存在大量中间 能级吸收可见光使膜色为深棕色 ,经热处理后颜色 未见变化 ,虽然有导电性但光透性较差.

表1是在衬底温度  $T_a \approx 280$  ℃的条件下,使用 不同氧浓度制备的 CIO 薄膜样品热处理前后的电学 参数,从表1可看出,随着溅射氧浓度的增加载流子 浓度呈现下降趋势 而且薄膜经热处理后 电阻率随 溅射氧浓度的增大而增加 这主要是由于氧空位逐 渐减少所致,在氩还原气氛中热处理后,载流子浓 度将增大是由于溶解在晶界及气孔中的富余氧被移 除引起的 造成氧电子陷阱减少而使载流子浓度增 加<sup>[4]</sup>.在氧浓度小于 4.8% 时载流子浓度下降得很 快 并日热处理后的电阻率很大 这可能是由于过低 的氧浓度将不足以维持尖晶石的结构框架使 CdIn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 含量减少.同时,由于膜中含有大量无序化 的 Cd Jn 原子,无规分布的原子引起势场起伏散射 载流子使迁移率降低 在氢浓度为48% 左右载流 子浓度达到最大 但热处理后电阳率亦很大 这是由 于有效质量增大使迁移率降低所致。

表 1 在衬底温度 T<sub>s</sub>≈280 ℃的条件下,使用不同氧浓度制备的 CIO 薄膜样品的载流子浓度(热处理前后)和电阻率(热处理后)

氧浓度	<i>n</i> 热处理前	<i>n</i> 热处理后	₽热处理后
1%	$/10^{26} \text{ m}^{-3}$	$/10^{26} \text{ m}^{-3}$	$/10^{-5} \Omega \cdot m$
4.0	0.465	0.596	10.21
4.8	3.853	5.728	5.32
5.0	0.721	1.642	1.76
7.7	0.433	1.072	1.89
10.0	0.236	0.551	3.22
20.0	0.096	0.122	5.32
30.0	0.104	0.095	21.7

鉴于大面积的导电膜将造成 *I<sup>2</sup> R* 损失的增加, 所以必须减小薄膜的方块电阻.这要求有高的载流 子浓度和高的载流子迁移率,但前者会增加自由载 流子对光的吸收,因此工作的重点应放在后者 上<sup>[13]</sup>.载流子迁移率 μ<sub>H</sub> 与载流子弛豫时间 τ 和有 效质量 m<sup>\*</sup> 的关系可表示为

$$\mu_{\rm H} = \frac{e \cdot \tau}{m_e^*}.$$
 (6)

由于有效质量的降低将导致自由载流子吸收带

向可见光谱转移<sup>[13]</sup>,所以提高载流子的弛豫时间将 成为关键所在.

根据第 2 节阐述的  $\alpha_{o}$ -T 关系 ,由( 2 )式可计算 载流子的有效质量,同时,利用测量得到的载流子迁 移率并根据(6)式可计算载流子弛豫时间,图5(a) 中的拟合曲线表明,电子的有效质量随载流子浓度 的增加而增加 这主要是由于载流子浓度的增加会 使费米能级升高从而使费米能级处导带的曲率逐渐 减小造成载流子有效质量变大,由于载流子的弛豫 时间与离子化杂质(如 V a, Inc., Cd. 和富余氧电子 陷阱等 对电子的散射有关 因此在热处理前后离子 化杂质的散射对迁移率的影响是不一样的,从图 5 (b)的拟合曲线可看出,在载流子浓度偏小的地方迁 移率随载流子浓度的增加而变大并在  $n = 7.0 \times 10^{25}$ m<sup>-3</sup>左右处达到最大值,这是由于在较高氧浓度条 件下制备时 膜内晶界附近有大量的氧电子陷阱散 射电子,经热处理后,氧电子陷阱急剧减少从而使它 对电子的散射减少,随着载流子浓度的进一步增加 有效质量也会随之变大 同时增多的施主杂质离子 对载流子的有效散射亦会增加并造成载流子弛豫时



图 5 CIO 薄膜中的载流子浓度与归一化有效质量(a)及与迁移率 <sub>24</sub>, 弛豫时间 <sub>c</sub>(b)的关系

间和迁移率的快速降低,但由于载流子浓度的增加 要比迁移率的降低快,总的效果是电阻率降低.在曲 线的末端载流子浓度较大的区域有效质量很大而迁 移率和弛豫时间变化相对较平缓,这是由于薄膜经 热处理后,载流子大的有效质量和低的散射对弛豫 时间具有相反的影响而涨消所致.从图 5(b)的曲线 可以看到,在载流子浓度 n = 1.0 × 10<sup>26</sup> m<sup>-3</sup>左右电 子的弛豫时间达到最大而有效质量相对较小,在此 位置薄膜的综合指标最理想.

综上所述,在分析了各种对电阻率和透光率影响的因素后,我们找到了氧浓度为8%左右时是 CIO 膜最佳的制备条件,经热处理后各项指标大约为:载流子浓度  $n = 1.0 \times 10^{-26} \text{ m}^{-3}$ ,迁移率  $\mu_{\rm H} = 31 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{V·s}$  电阻率  $\rho = 1.89 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}$ .

### 4.结 论

通过氧空位、掺杂点缺陷及氧电子陷阱对载流 子的浓度和散射的影响解释了缺陷态 CIO 薄膜的导 电机制.在制备过程中,温度控制在 T<sub>s</sub> ≈ 280 ℃时, 薄膜透光性最好.在制备大面积 TCOs 时要综合考 虑载流子的浓度、迁移率、弛豫时间和有效质量等指 标,重点应放在提高弛豫时间上.因此必须控制杂质 离子的数目,在杂质离子对电子散射和由它产生的 载流子浓度之间找到一个平衡点,通过适当的热处 理和选择合适的氧分压即可达到目标.实验分析表 明,在氧分压为 8% 左右制备的 CIO 薄膜导电性和 透光性最好.

- [1] Fan J C C , Bachner F J 1976 Appl. Opt. 15 1012
- [2] Mehta R R, Vogel S F 1972 J. Electrochem. Soc. 19 752
- [3] Peng D L , Jiang S R , Xie L 1993 Phys. Stat. Sol. A 136 441
- [4] Zakrzewska K, Pisarkiewicz T, Czapla A 1987 Phys. Stat. Sol. A 99 141
- [5] Feng B X, Xie L, Wang J et al 2000 Acta Phys. Sin. 49 2066 (in Chinese) [冯博学、谢 亮、王 君等 2000 物理学报 49 2066]
- [6] van der Pauw L J 1958 Philips Res. Rep. 1 13
- [7] Pisarkiewicz T, Zakrzewska K, Leja E 1987 Thin Solid Films 153 479

- [8] Smith R A 1959 Semiconductors (Cambridge :Cambridge University Press )
- [9] Wu X, Coutts T J, Mulligan W P 1997 J. Vac. Sci. Technol. A 15 1057
- [10] Wei S H , Zhang S B 2001 Phys. Rev. B 63 45112
- [11] Mahan G D 1980 J. Appl. Phys. 51 2634
- [12] San H S, Li B, Feng B X et al 2005 Acta Phys. Sin. 54 842(in Chinese [ 伞海生、李 斌、冯博学等 2005 物理学报 54 842]
- [13] Coutts T J , Young D L ,Li X 2000 MRS Bull . 25 58

## Study on electrical properties of n-type transparent and conductive CdIn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> thin film and the optimum preparation parameters for large-area film \*

San Hai-Sheng Chen Chong He Yu-Yang Wang Jun Feng Bo-Xue<sup>†</sup>

 (Key Laboratory for Magnetism and Magnetic Material of Ministry of Education , Lanzhou University , Lanzhou 730000 , China )
 (Received 30 March 2004 ; revised manuscript received 17 November 2004 )

#### Abstract

Transparent and conductive oxides  $CdIn_2O_4$  thin films were prepared by radio-frequency reactive sputtering from a Cd-In alloy target in Ar +  $O_2$  atmosphere. The structure and constitution of the films were obtained by x-ray diffraction. All films prepared contained the polycrystalline  $CdIn_2O_4$  while a secondary crystalline phase of CdO was also present. Theoretically , it is proposed that three types of point defects play the most important role in affecting the carrier concentration and the scattering of conduction electrons , namely , oxygen vacancies , impure point defects and dissolved surplus oxygen trap centers. By the measurement and computing for Hall and themopower , we could get carrier concentration , Hall mobility , effective mass and relaxation time. At the same time , this paper formulated the effect on optical band-gap due to band-gap narrowing and Burstein-Moss ( B-M ) shift , and a proper substrate temperature , namely  $T_s \approx 280$  °C , was used in sputtering for getting higher transmittance of light. Analysis indicated that better thin films were prepared at oxygen density of 8%. By post-deposition heat treatment , a charge-carrier mobility of  $31 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$  and resistivity of  $1.89 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}$  were obtained , and the thin films also retain high visible transmittance.

Keywords : radio-frequency reactive sputtering , transparent and conductive CdIn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> thin films , conductive mechanism , bandgap narrowing
PACC : 6855 , 8155C , 7360

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 69876018) and National High Technology Development Program of China (Grant No. 2001AA312190).

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Corresponding author. E-mail : fengbx@lzu.edu.cn